

TERCERA REUNIÓN DEL SUBGRUPO DE TRABAJO DE INSTRUMENTOS DE DEUDA VINCULADOS A LA TIIE DE FONDEO

AGENDA

Ciudad de México, México

3 de junio de 2021

14:00 – 15:00 hrs.

PUNTOS A ABORDAR

1. Bienvenida
2. Avances de la transición a nivel internacional
3. Desarrollo del mercado de deuda ligado a la TIIE de Fondeo
4. Emisión de productos de deuda ligados a la TIIE de Fondeo
5. Comentarios finales y detalles de la próxima reunión